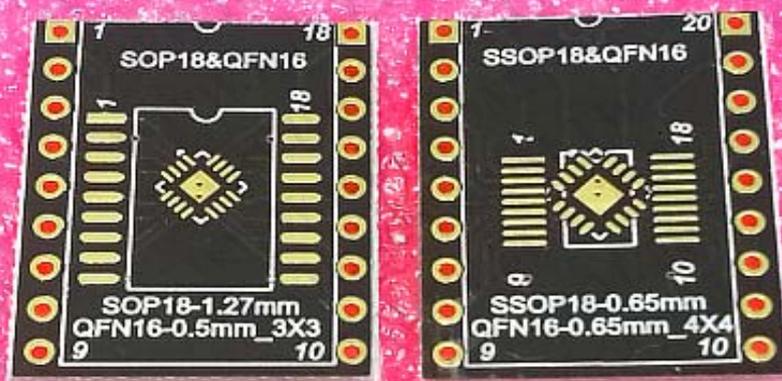


<b>【名称】</b> ：SOP18 SO18 SOIC18 转 DIP18、MSOP18 TSSOP18 转 DIP18、QFN16 转 DIP 支持 Pitch=0.65mm & 0.5mm
<b>【型号】</b> ：MP1816S1
<b>【品牌】</b> ：SmartCool
<b>【描述】</b> ：  板材：FR4 板材，板色：黑色，板層：2層，板厚：1.6mm，銅厚：1OZ，焊盤：採用化學沉金工藝（即焊盤表面特殊鍍金） 尺寸：23*18*1.6mm 用途：本轉接板適用於以下晶片封裝【①、Pitch（腳與腳間距）=1.27mm 的 SO18、SOIC18、SOP18；②、Pitch（腳與腳間距）=0.65mm 的 SSOP18、TSSOP18、MSOP18；③、Pitch（腳與腳間距）=0.65mm 的 QFN16；④、Pitch（腳與腳間距）=0.5mm 的 QFN16】 特點：可支援多個貼片封裝晶片轉外掛程式（但每個板一次只能焊接一個晶片轉外掛程式）

## SOP18 TSSOP18 QFN16转DIP



兼容以下封裝：

SOP18 SOIC18-1.27mm

TSSOP18 SSOP18-0.65mm

QFN16-0.65mm

QFN16-0.5mm